

2012年12月7日  
株式会社日立製作所

## 情報・通信機器向け半導体製造事業の終了について

株式会社日立製作所(執行役社長:中西 宏明/以下、日立)は、このたび、情報・通信システム事業の競争力強化に向けた経営リソースの最適配置を目的として、情報・通信機器など向けの半導体の自社製造事業を終了することを決定しました。具体的には、2014年3月31日付で情報・通信システム社マイクロデバイス事業部における半導体集積回路の製造を終了します。今後は、情報・通信機器などの日立グループ製品向けを中心に、LSIの開発・設計・品質保証に特化して経営の合理化を図るとともに、製造に関連する人財をはじめとする経営リソースを日立グループ内で最適配置することを通じて、情報・通信システム事業のグローバルでの競争力強化を図ります。

日立は、1975年に、情報・通信機器向けの半導体集積回路の開発を目的として、デバイス開発センターを設立しました。その後、2004年にマイクロデバイス事業部に組織改正し、日立グループおよび社外顧客向けに、情報・通信機器や計測器・医療・産業分野などで用いられる半導体集積回路の設計・開発・製造・販売を行ってきました。

近年、半導体業界では、開発・設計と製造の水平分業化が進展しており、日立においても、当該事業の競争力の維持・強化に向けて、製造コスト削減や生産効率向上に取り組むとともに、一部製品の生産について外部委託化を推進してきました。こうした中、情報・通信システム事業全体の競争力強化に向けた経営リソースの最適配置を目的として、このたび、マイクロデバイス事業部における半導体集積回路の製造を終了し、外部委託化することを決定しました。今後は、情報・通信機器などの日立グループ製品向けを中心に、LSIの開発・設計・品質保証に特化するとともに、製造に関連する人財をはじめとする経営リソースを日立グループ内で最適配置します。人財の移管先などの詳細については、今後検討を進めていきます。

日立は、ITで高度化された社会インフラを提供する「社会イノベーション事業」のグローバル展開による成長をめざし、中核事業の一つとして情報・通信システム事業の強化を進めています。今回の決定により、グローバルにおける情報・通信システム事業の競争力強化を加速していきます。

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---